

## 概要

この通知は、少量の FCBGA、BGA および QFP の出荷に用いる複数製品をパッキングする新しい手法に、真空型トレイ パッキングが追加されたことをお知らせするものです。

## 内容

トレイの一部のみを使用して出荷する場合のパッケージング オプションおよび出荷ソリューションとして、ザイリンクスでは FCBGA、BGA および QFP パッケージ製品向けに複数製品をパッキングする新しい手法を採用します。この手法では、出荷に真空型トレイを用います。

新しい真空型トレイは、ESD でコーティングされた APET (非晶性ポリエチレン テレフタレート) を原料としています。このトレイでは、デバイスのパッキングと運搬時の保護用のくぼみに、デバイス保護のための運搬用テープ (65mm、44mm、または 24mm) を部分的に使用しています。真空型トレイの蓋は、運搬中にデバイスを抑える役割を果たします。

この真空型トレイには 1 つまたは複数ユニットをパッキングでき、1 ユニットまたは最大 5 ユニットのパッキングが可能です。ザイリンクスでは、2 つ以上のデバイスを同じトレイに混在させて格納することはありません。また、既存の JEDEC トレイと新しい真空型トレイの同時出荷は認めていません。

### 参考資料 / 添付 :

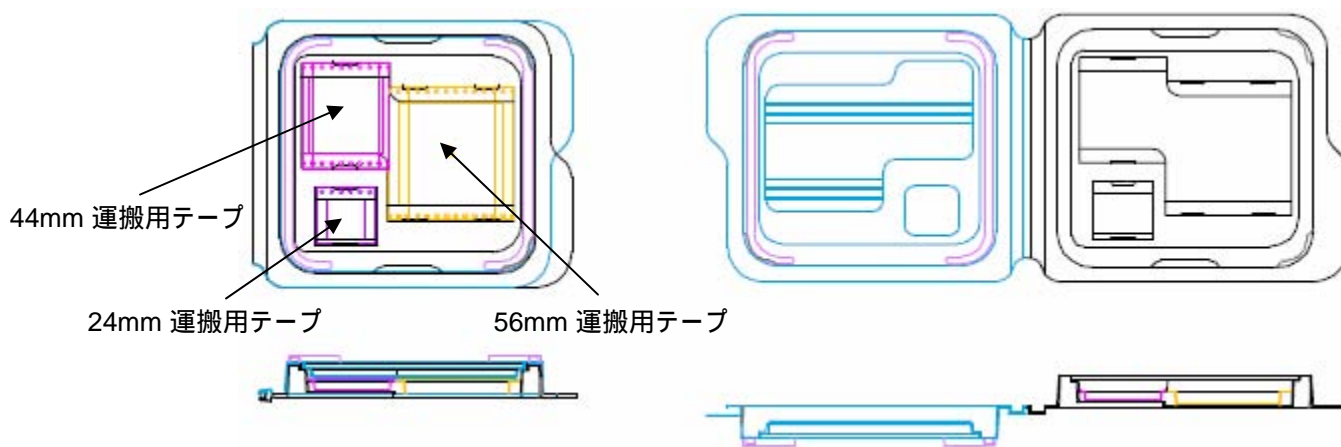


図 1-1 ユニット用真空型トレイ

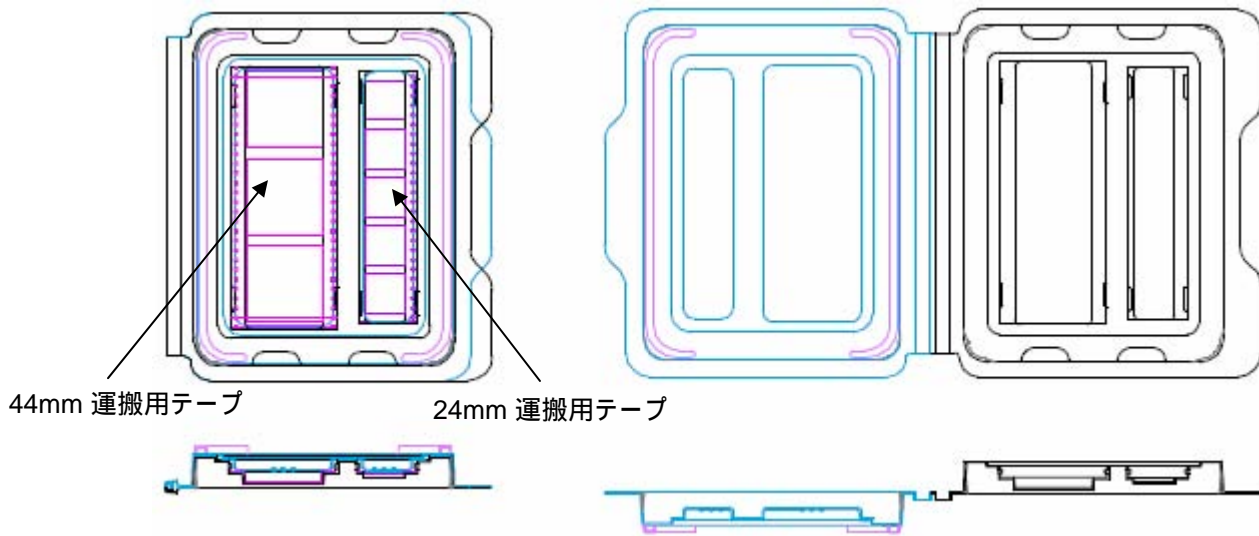


図 2 – 複数ユニット用真空型トレイ

## 該当製品

この通知は、1 ユニットから最大 5 ユニットでの注文の際に JEDEC トレイを用いて出荷される、ザイリンクスの BF/BFG、BG/BGG、CP/CPG、CS/CSG、EF/EFG、FF/FFG、FG/FGG、FT/FTG、FS/FSG、HT/HTG、HQ/HQG、MQ/MQG、QF/QFG、TQ/TQG、および VQ/VQG パッケージ製品すべてに該当します。

## キー デート

ザイリンクスは、複数製品をパッキングする新しい手法と真空型トレイの使用を 2008 年 8 月 15 日から開始します。

## お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。ご不明な点、ご質問等ございましたら [ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせ下さい。

**重要なお知らせ**：カスタム変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のサポートウェブ サイト(<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail によるアラート配信として受信しています。アラートにご登録後、My アラートにカスタム変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。これにより、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション のアラートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法は、[ザイリンクス アンサー # 18683](#) を参照して下さい。

## 改定履歴

次の表に、この通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2008/08/11	1.0	初版リリース

この通知は、英語版 (XCN08020、バージョン 1.0、2008 年 8 月 11 日発行) を翻訳したものです。